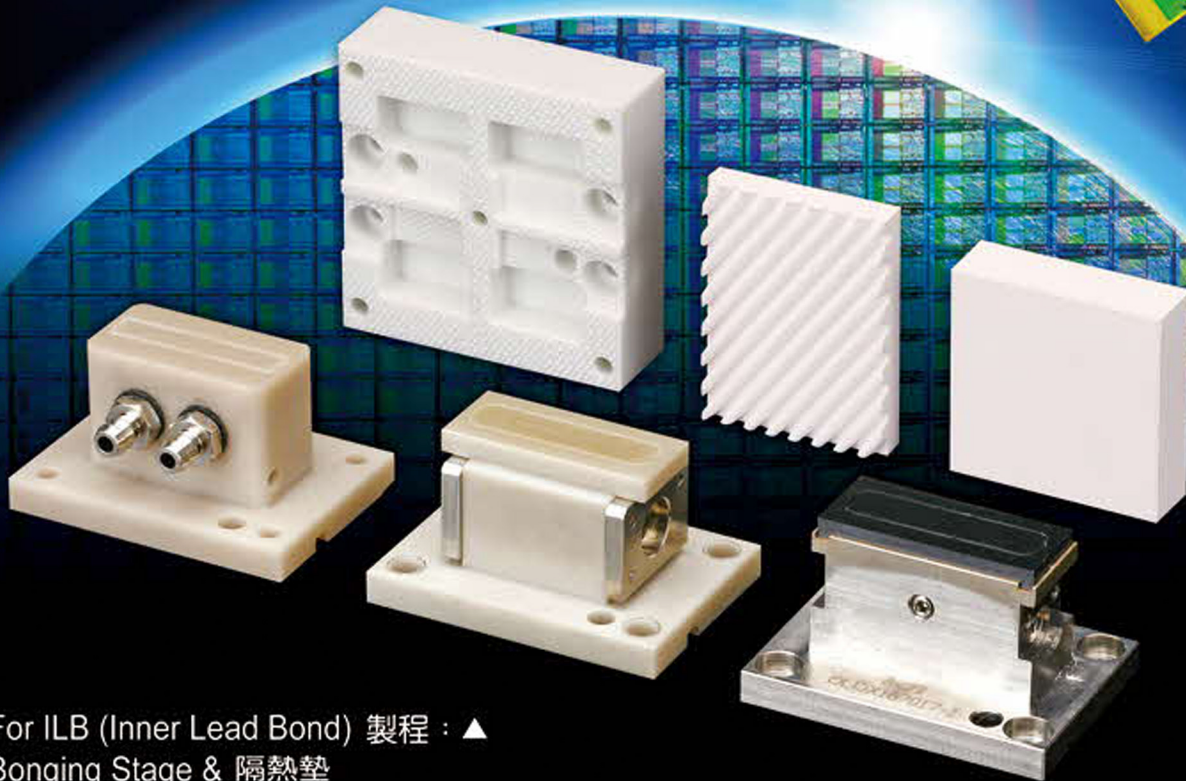
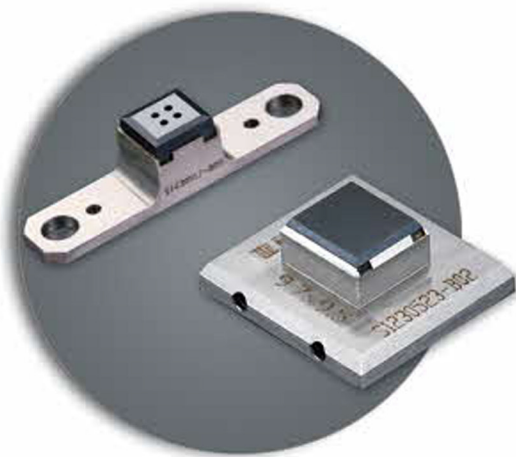




壓合模具 Bonding Tooling



For ILB (Inner Lead Bond) 製程 : ▲
Bonding Stage & 隔熱墊



- 高精密度，PV值可達 $\pm 1\mu\text{m}$
- 使用鑽石、陶瓷等科技材料
- 具有極高耐高磨性與耐熱變形量

◀ For LOC (Lead On Chip) 製程 :
Mount Tool & Stage



KINIK 中國砂輪企業股份有限公司 **KINIK COMPANY**

239010新北市鶯歌區中山路64號 TEL:886-2-26791931 FAX:886-2-26703031
<https://www.kinik.com.tw>